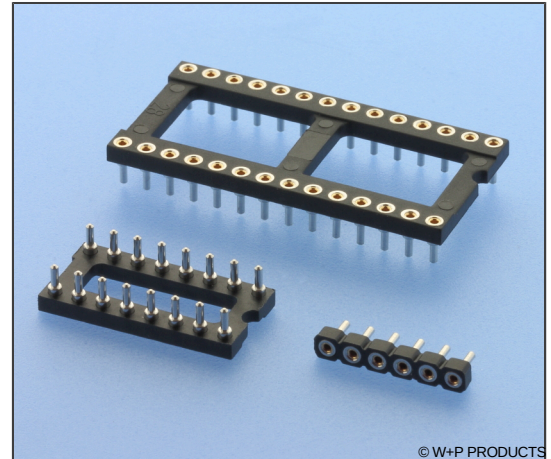


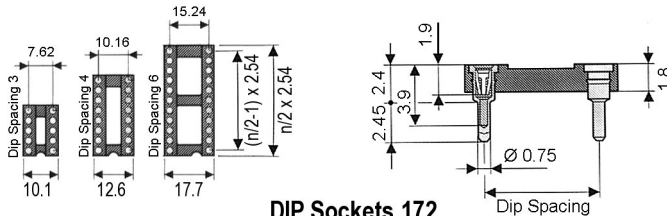
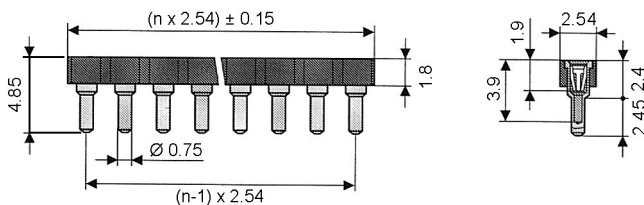
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c <i>RoHS Exemptions 6a-I / 6c</i>	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21 <i>6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Withstanding Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.

**DIP Sockets 172****IC Headers 186**

n	DIP (Code)	DIP [mm]
06-10	3	7.62
14-24		
28		
20-24	4	10.16
28		
24		
28	6	15.24
32		
36		
40		
48/50		

Series 172 172 IC-Fassung IC-Socket	Contacts* 14 06-10/14-24/28/ 32/36/40/48/50 DIP Spacing Optionen entspr. Tabelle DIP spacing options pl. see table	DIP Spacing* 3 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm	Sleeve Plating 50 50 Sn (Standard)	Clip Plating* 00 00 Au flash 10 Au 0,25µm (Option) 30 Au 0,75µm	Leadfree (Optional)* LF21 LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c On request leadfree without RoHS exemption 6c
Series 186 186 IC-Leiste IC-Strip	Contacts* 14 01-64 Einreihig Single row	Rows 1 1 Einreihig Single row	Sleeve Plating 50 50 Sn (Standard)	Clip Plating* 00 00 Au 10 Au 0.25µm (Option) 30 Au 0.75µm	Leadfree (Optional)* LF21 LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c On request leadfree without RoHS exemption 6c

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

